

证券代码：873693

证券简称：阿为特

公告编号：2024-085

上海阿为特精密机械股份有限公司

投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（电话会议）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年10月7日

活动地点：电话会议

参会单位及人员：西南证券、中信建投基金、中金做市、建信基金、东莞证券、首创证券、东北证券、贝寅资产、泰康基金、招商基金、晨鸣资管、指南基金、少年资本、敖基投资、国海证券和长信基金

上市公司接待人员：董事、副总经理、董事会秘书、财务总监谢振华先生

三、投资者关系活动主要内容

问题 1：请介绍一下公司在精密制造领域的技术积累和技术优势？

回答：公司自成立以来，高度重视技术研发工作，秉承创新驱动发展的理念，始终专注以技术创新推动科技成果转化，通过多年研发和积累，公司具备了以金属零部件精密制造技术为核心的研发制造能力，打造了一支对行业技术发展和应用前沿领域有深入理解的专业研发团队。截至目前，公司已取得各类专利 75 项，其中发明专利 13 项，实用新型专利 62 项；软件著作权 1 项。公司根据市场和客户的需求，通过自主研发不断积累核心技术，在多年的生产实践中，公司产品结构、生产工艺不断优化、改进、创新。目前掌握了包括质谱仪高精密高真空腔体工艺、低温微米推进机构的关键制造技术、超精密铝合金气浮导轨的工艺、交叉孔无毛刺技术在内的多项核心技术。

在研发团队建设上，一方面，研发团队核心成员具备了以金属零部件精密制造技术为核心的研发制造能力，他们曾获得国务院特殊津贴、全国五一劳动奖章、全国总工会职工技术成果二等奖、首届“长三角大工匠”等荣誉。另一方面，公司高度重视人才储备工作，制定并实施了详细、健全的管培生管理体系，每年从高校招聘一定数量的应届毕业生，从生产一线到技术研发实行逐步、系统的培养。

在数字化、信息化建设方面，公司坚持精细化管理的提升，持续推进数字化改革，致力于打造数字化工厂。（1）PLM 系统实现了项目管理，产品管理，工艺管理，数据库管理,ECO 管理，流程管理，知识库管理，并对接 ERP、MES 系统；（2）产品开发工程师们长期熟练应用 UG、SolidWorks、Esprit 等各种全球领先的 CAD 和 CAM 技术，建立阿为特技术参数模型，广泛应用于产品研发、工艺设计及制造中；（3）通过 Vericut 模拟仿真加工过程，进行优化加工工艺，提升加工效率，降低数控程序在调试过程造成的产品质量和安全风险。

问题 2：请介绍公司和赛默飞之间的合作渊源？公司如何做到与赛默飞之间保持多年稳定的合作关系以及高的客户粘性？

回答：十多年前有机会参与客户产品的研发，并且通过了客户的质量认证，在此基础上，逐步获得客户的认可与信任，建立了战略合作关系。多年来，公司在赛默飞的高速增长中也贡献出了阿为特力量。在与赛默飞的合作中，我们高度配合与支持客户的研发工作，使得客户的需求在我司的一站式服务中得到解决。通过日积月累的技术沟通和合作信任，使得我们服务的产品范围从单个零件逐步扩展到装配部件，产品结构逐渐多元化，与客户的粘性逐渐增强。

问题 3: 请介绍下公司半导体业务发展的契机是什么？目前的公司半导体进展如何？公司在半导体业务领域的规划以及未来发展需要突破的重点有哪些？

回答: AI 人工智能、XR 扩展现实、汽车的驱动需求回暖，当下游终端产品技术迭代更新，激增的需求将带动资本向上游晶圆厂涌入，推动国内晶圆厂持续扩产，成为半导体设备销售额增长的主要驱动力之一。全球半导体设备行业随下游终端产品景气度每隔 3-4 年会呈周期性变动趋势。根据中金企信国际咨询的预测，2022-2027 年中国大陆半导体设备销售预计年增长 12%。高投入支撑长期增长，国内零部件市场规模广阔。

公司始终将半导体领域作为未来的战略发展方向，目前拥有千级洁净室及清洗线，具备了生产半导体领域相关产品的能力。

在人员配置方面，半导体项目团队人员配备了经验丰富的研发技术人员及高技能精密加工及产品调试人员。随着公司在半导体类产品领域的投入持续加大，积极参与到重要机型的新项目研发，对客户华海清科在 2024 年上半年的新产品开发达 50 余种。同时，随着公司在半导体领域技术的不断迭代以及公司与华海清科之间合作的深入，一百多款零件在 2024 年上半年也逐步量产。公司在半导体领域的产品结构也同步得到优化，结构复杂、超高精密度的核心零件不断增加，为半导体业务的持续快速增长和精密零件生产的技术提高打下了坚实基础。

研发投入较大、研发周期较长是生产半导体类产品所面临的重点问题，半导体设备延续行业“摩尔定律”，快速迭代，因此快速报价和打样是关键。半导体设备精密零部件具有高精密、高洁净、超强耐腐蚀能力和耐击穿电压等特性，其生产工艺涉及精密机械加工、材料、表面处理和工程设计等多个领域。随着上海工厂今年 8 月份完成搬迁和新设备的陆续购置，相关精密加工能力逐步提高。

未来，公司坚持高度柔性化的生产管理体系，对半导体设备中的微米级高精度、结构复杂的零部件，公司力争做到快速报价、打样，实现敏捷制造。

上海阿为特精密机械股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 9 日